

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 1 区分  
 【発行日】平成 18 年 7 月 13 日 (2006.7.13)

【公開番号】特開 2004-103569 (P2004-103569A)  
 【公開日】平成 16 年 4 月 2 日 (2004.4.2)  
 【年通号数】公開・登録公報 2004-013  
 【出願番号】特願 2003-199685 (P2003-199685)  
 【国際特許分類】

**H 0 1 J      9/02      (2006.01)**

**H 0 1 B    13/00      (2006.01)**

【F I】

H 0 1 J      9/02                      E

H 0 1 B    13/00            5 0 3 D

【手続補正書】  
 【提出日】平成 18 年 5 月 15 日 (2006.5.15)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】明細書  
 【補正対象項目名】特許請求の範囲  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に、パターンニングされた部材を備える部材パターンの製造方法であって、  
前記パターンニングされた部材の形成工程が、前記基板上に予め配置された部材上から前記基板上に跨って付与されたネガタイプの感光性材料の所望領域を、第 1 の方向から露光する第 1 の露光工程と、前記第 1 の露光工程の後、現像して、前記部材の前駆体パターンを形成する現像工程と、前記部材の前駆体パターンを前記第 1 の方向とは逆の第 2 の方向から露光する第 2 の露光工程と、前記第 2 の露光工程の後、前記前駆体パターンを焼成する工程と、を備えることを特徴とする部材パターンの製造方法。

【請求項 2】

前記基板上に予め配置された部材は、前記基板よりも光反射率の大きい部材であることを特徴とする請求項 1 に記載の部材パターンの製造方法。

【請求項 3】

前記基板上に予め配置された部材は、感光性材料への露光、現像と焼成を伴う方法にて形成された部材であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の部材パターンの製造方法。

【請求項 4】

前記基板上に予め配置された部材は、その断面形状が、オーバーハングした部分を有することを特徴とする請求項 1 乃至 3 いずれか 1 項に記載の部材パターンの製造方法。

【請求項 5】

前記パターンニングされた部材は絶縁性部材であって、前記絶縁性部材は、当該絶縁性部材を挟んで前記基板上に積層される一对の導電性部材を電氣的に接続するためのコンタクトホールを有していることを特徴とする請求項 1 乃至 4 いずれか 1 項に記載の部材パターンの製造方法。

【請求項 6】

基板上に、第 1 の配線と、前記第 1 の配線と交差し、当該第 1 の配線上に、絶縁体を介して配置された第 2 の配線とを備える配線構造体の製造方法であって、  
 前記絶縁体の形成工程が、基板上に配置された第 1 の配線上から前記基板上に跨って付

与されたネガタイプの感光性絶縁材料の所望領域を、第 1 の方向から露光する第 1 の露光ステップと、前記第 1 の露光ステップの後、現像して、前記絶縁体の前駆体パターンを形成するステップと、前記絶縁体の前駆体パターンを前記第 1 の方向とは逆の第 2 の方向から露光する第 2 の露光ステップと、前記第 2 の露光ステップの後、前記前駆体パターンを焼成するステップと、を備えることを特徴とする配線構造体の製造方法。

【請求項 7】

前記第 1 の配線は、前記基板よりも光反射率の大きい部材であることを特徴とする請求項 6 に記載の配線構造体の製造方法。

【請求項 8】

前記第 1 の配線は、感光性材料への露光、現像と焼成を伴う方法にて形成された部材であることを特徴とする請求項 6 又は 7 に記載の配線構造体の製造方法。

【請求項 9】

前記第 1 の配線は、その断面形状が、オーバーハングした部分を有することを特徴とする請求項 6 乃至 8 いずれか 1 項に記載の配線構造体の製造方法。

【請求項 10】

前記絶縁体は、当該絶縁体を挟んで前記基板上に積層される一对の導電性部材を電氣的に接続するためのコンタクトホールを有していることを特徴とする請求項 6 乃至 9 いずれか 1 項に記載の配線構造体の製造方法。

【請求項 11】

基板上に、第 1 の配線と、前記第 1 の配線と交差し、当該第 1 の配線上に、絶縁体を介して配置された第 2 の配線とを備える配線構造体と、前記配線構造体に接続された電子放出素子とを有する電子源の製造方法であって、前記配線構造体は請求項 6 乃至 10 いずれか 1 項に記載の方法にて製造されることを特徴とする電子源の製造方法。

【請求項 12】

基板上に、第 1 の配線と、前記第 1 の配線と交差し、当該第 1 の配線上に、絶縁体を介して配置された第 2 の配線とを備える配線構造体と、前記配線構造体に接続された電子放出素子と、前記電子放出素子からの電子の照射により画像を表示する画像表示部材とを有する画像表示装置の製造方法であって、前記配線構造体は請求項 6 乃至 11 いずれか 1 項に記載の方法にて製造されることを特徴とする画像表示装置の製造方法。